

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260728

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	2026 年 7 月 28 日上午 9:30~11:00：华泰证券：胡晓海、吴莹、薛振一、王晓彤，招商证券：周铮、左顺、赵雨泉、董钊、曾劲松、袁琪、熊炜、胡飞、林煜、胡露、李婷、熊蓓蓓、朱锴、谭圣齐、陈吉煜等，共 39 名投资者及证券人员
时间	2026 年 7 月 28 日上午 9:30~11:00
地点	公司 6 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026 年 7 月 28 日上午 9:30~11:00：董事长助理兼投关总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	公司介绍： 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。 问 1：请问公司高端晶圆光刻胶业务最新进展如何？未来上量和产能释放预期是怎样的？ 答：公司高端晶圆 KrF/ArF 光刻胶于潜江布局两大产线，其中一期年产 30 吨产线保持稳定运行；二期年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶量产产线已于本年度 3 月建成投产，系国内首条全流程自主化高端光刻胶量产产线。截至上半年度，公司已有 8 款高端晶圆光刻胶产品（ArF 光刻胶、KrF 光刻胶各 4 款）获得国内多家主流晶圆厂批量订单，较今年一季度末新增 5 款；另有多款产品预计于本年度内实现订单转化。公司持续加快产品交付推

	进力度，2026 年上半年产品交付规模有望实现明显增长，商业化落地进程持续提速。产品验证方面，公司累计规划开发 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款产品已向下游客户送样开展验证工作，其中超 10 款进入加仑样测试阶段。与此同时，公司同步布局多款配套 BARC、SOC 等光刻配套材料，相关产品商业化推进节奏持续加快。 受下游客户验证周期、产品导入进度逐步推进等因素影响，现阶段产线稼动率仍处于爬坡阶段。后续公司将持续推动多款在研产品完成客户验证并实现订单转化，依据订单落地情况稳步提升产线稼动水平。排产及产能释放方面，短期优先保障已实现批量供货产品的生产交付，持续推动在测产品完成加仑级验证、加速订单转化；中长期，公司将密切跟踪国内晶圆制造企业扩产规划与半导体材料国产化导入进程，结合下游客户长期需求动态优化排产方案、有序推进产能释放，充分匹配高端晶圆光刻胶国产替代市场发展需求。 问 2：公司 半导体材料领域的产品线布局有哪些，分别有哪些新进展？ 答：公司 CMP 抛光垫已实现规模化产业化落地，在国内晶圆制造领域建立领先市场地位。依托平台化精细化工技术积累，公司同步推进多品类半导体材料的研发开发、客户验证及产业化建设，各产品线均按照既定规划有序落地： CMP 配套材料（抛光垫、抛光液、清洗液）：多款适配铜阻挡层、大硅片、碳化硅衬底、TSV 工艺的专用抛光液持续取得进展，多个产品型号通过头部晶圆厂全流程验证并斩获批量订单；仙桃抛光液产业园产线稳步建设，同时实现研磨粒子自主配套，持续完善 CMP 材料一体化供应能力。面向玻璃基板、超大尺寸应用场景的新一代抛光垫研发及客户送样工作有序推进；潜江三期抛光垫产线已开工建设，针对新兴应用赛道需求提前布局产能。 高端晶圆 KrF/ArF 光刻胶：潜江二期年产 300 吨全流程自主化量产产线建成投产，叠加一期产线，合计形成 330 吨有效产能，现阶段整体处于产能爬坡阶段。公司累计布局四十余款高端晶圆光刻胶产品，多款型号持续在国内头部晶圆厂开展验证测试；目前已有 8 款 ArF、KrF 光刻胶实现稳定批量供货，并持续拓展新增客户订单。与此同时，公司推进光刻树脂、光产酸剂等上游关键原材料自主合成，布局配套 BARC、SOC 等光刻辅材，搭建完整自主供应链体系。 半导体先进封装材料：半导体封装 PI 材料已布局 7 款产品，其中 2 款获得多家客户订单；临时键合胶在现有客户实现稳定规模化出货基础上，持续深化市场拓展与多场景应用推广。 半导体显示材料：PSPI、TFE 封装墨水等产品实现 G8.6 高世代产线批量供货；YPI 产线完成升级试运行，持续夯实柔性显示上游材料国产化竞争优势，配合面板厂商开展新项目工艺认证。 半导体材料行业具备技术壁垒高、客户准入周期长的特点，新产品从送样验证到大规模放量需要循序渐进。公司将持续加大研发投入，推动各产品线加快客户导入与订单转化。
--	--

问 3：如何看待行业终端需求的扩张，以及公司是否有相应的产能储备？

答：公司推进各类半导体新材料产能布局，相关规划均基于国内晶圆制造、先进封装、新型显示等下游产业中长期扩产趋势与国产替代节奏，结合客户验证进展、潜在订单需求统筹前瞻布局。

从行业供需格局分析，国内半导体关键材料长期依赖海外供应，高端品类国产化率仍然偏低，具备全流程自主量产能力的本土供应商较为稀缺，中长期国产替代空间充足。同时行业呈现结构性分化特征：低端通用材料市场竞争逐步加剧，而拥有自主技术壁垒、可适配头部客户先进工艺的高端材料仍处于供给紧缺状态。

公司遵循“需求导向、分步投放”的产能建设原则，采用“先小批量验证、再渐进扩产、有序爬坡释放”的模式推进产线建设，规避盲目集中大规模投产。分业务来看：CMP 抛光垫为公司成熟核心产品，下游需求保持稳健，现有主力产线维持较高产能利用率，新增产能重点布局玻璃基板、大硅片、先进封装等高增长新兴应用领域；高端晶圆光刻胶、CMP 抛光液、先进封装材料尚处在客户验证与产能爬坡阶段，产能投放将紧密结合下游晶圆厂认证进度、批量订单落地情况动态调整；显示材料业务依托成熟量产产线，保障头部面板客户稳定供货。

针对产能，公司建立多重管控机制：一是加强与下游客户前置沟通对接，产能规划联动重点客户中长期采购意向；二是推行柔性生产排产模式，新建产线预留工艺调试弹性，优先保障完成验证、具备批量订单产品的生产交付；三是持续拓展境内外客户资源，加快海外市场开拓，拓宽产能消化渠道；四是不断优化产品结构，重点研发高壁垒新产品，依靠技术优势规避同质化低价竞争。

问 4：公司同步布局多种电子材料赛道，平台化多品类布局具备哪些差异化核心优势？跨品类客户协同转化的落地成效如何？

答：平台化多材料协同布局是公司长期发展积淀形成的核心特色优势，价值主要体现在客户资源互通、底层技术复用、跨品类订单转化三大层面。首先客户资源高度协同。高端晶圆光刻胶、CMP 系列材料面向晶圆制造客户，柔性显示材料服务显示面板厂商，先进封装材料适配封测企业。同一下游客户可同步采购公司多品类电子化学品，持续提升单一客户配套规模。例如多家晶圆制造客户同步采购抛光垫、抛光液、高端晶圆光刻胶及配套湿电子化学品，一站式材料配套有助于优化客户供应链管理效率。其次是底层技术跨赛道共享。高分子合成、高纯化、精密涂布等属于各产品线通用核心技术，研发设施、高端检测平台与专业技术团队可跨业务板块统筹共用，有效提升新产品开发效率。典型如光刻胶树脂合成相关技术，可迁移应用于 PSPI 聚酰亚胺、先进封装材料的研发迭代。除此之外，跨品类订单转化成效逐步显现。已有多家客户在导入公司 CMP 系列耗材的基础上，同步启动高端晶圆光刻胶验证工作；依托已建立的稳定合作基础，能够有效缩短新品认证周期。后续随着各产品线持续完成客户验证，多品类协同配套价值将进一步凸显，平台化运营红利有望持续释放。

	问 5：公司收购的皓飞新材盈利能力如何？本次收购所形成的商誉未来是否存在减值风险？ 答：本次收购皓飞新材，是公司拓展新能源锂电材料赛道、落实平台化先进材料发展战略的重要布局，有利于丰富公司功能性高分子材料产品矩阵，促进新材料领域技术协同与客户资源共享。皓飞新材主营锂电分散剂、粘结剂等新能源材料，下游契合锂电产业发展趋势，赛道具备较好成长空间。依托产品技术优势，标的持续推进头部动力电池厂商导入，经营规模稳步拓展。标的相关财务数据、业绩相关安排已在本次收购相关公告中详细披露，请您查阅公告内容。 关于本次收购形成商誉及减值风险，公司已建立健全商誉全流程管理体系，严格按照企业会计准则及监管相关规定做好商誉管理。每年年末，公司将聘请具备相应资质的独立第三方评估机构开展商誉减值专项测试，持续动态跟踪皓飞新材订单落地、客户验证、营收及业绩兑现情况，及时研判经营指标变动对商誉价值产生的影响。当前皓飞新材所处下游赛道景气度向好，上市公司亦将充分发挥产业协同优势，助力标的持续开拓市场、稳固经营基本面。结合现阶段经营态势分析，暂不存在大额商誉集中减值风险。后续公司将持续推进投后整合，常态化跟踪标的经营运行，持续优化整体业务结构与盈利水平，推动公司由细分领域领先企业向综合型创新材料龙头稳步发展，充分释放长期成长潜力。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 28 日